

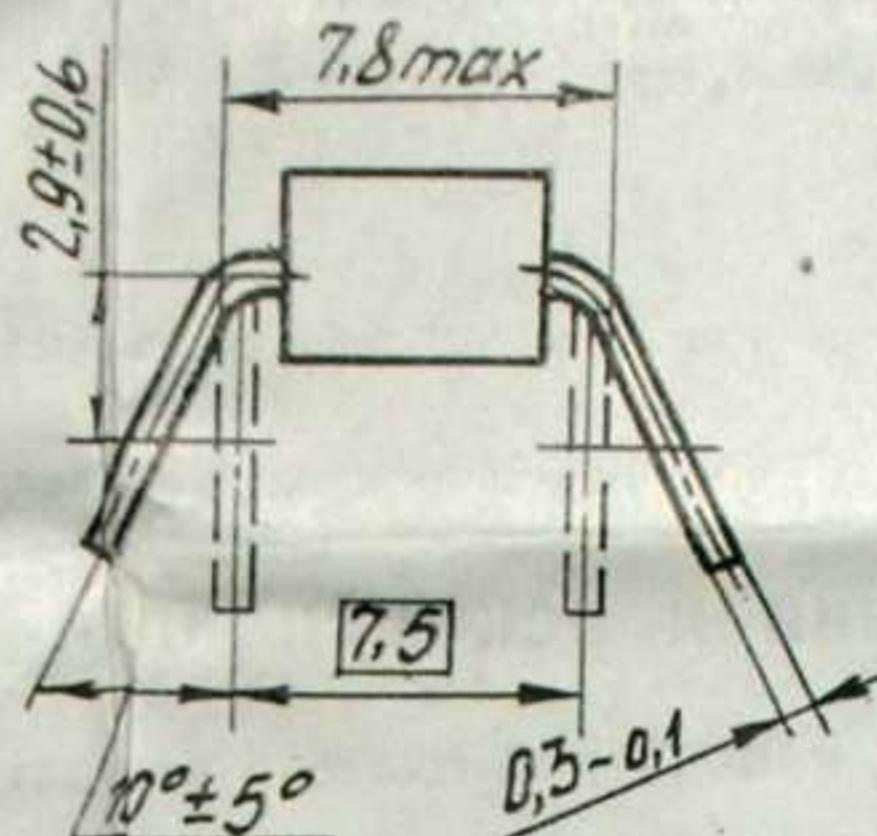
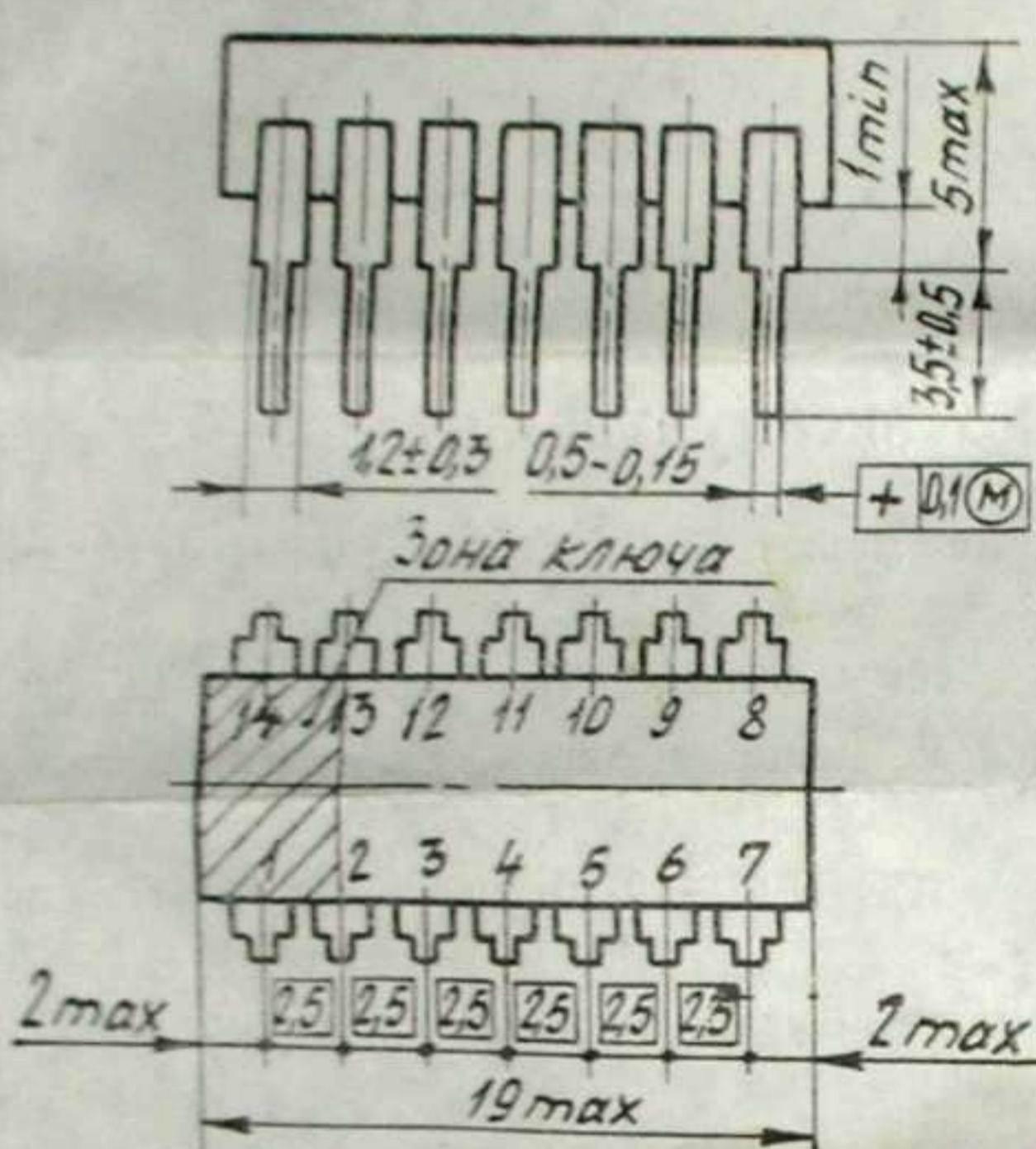
ПАСПОРТ

Микросхема К1ТК551

соответствует техническим условиям часть2 И6/бКо. 348.006ТУ1

Функциональное назначение—триггер $\bar{J}-\bar{K}$ с логикой на входе „З-И“.

Габариты



Время до прихода синхроимпульса t_n	Время после прихода синхроимпульса t_{n+1}
Вход X_2, X_3, X_4	Вход X_6, X_7, X_8
0	0
1	0
0	1
1	1

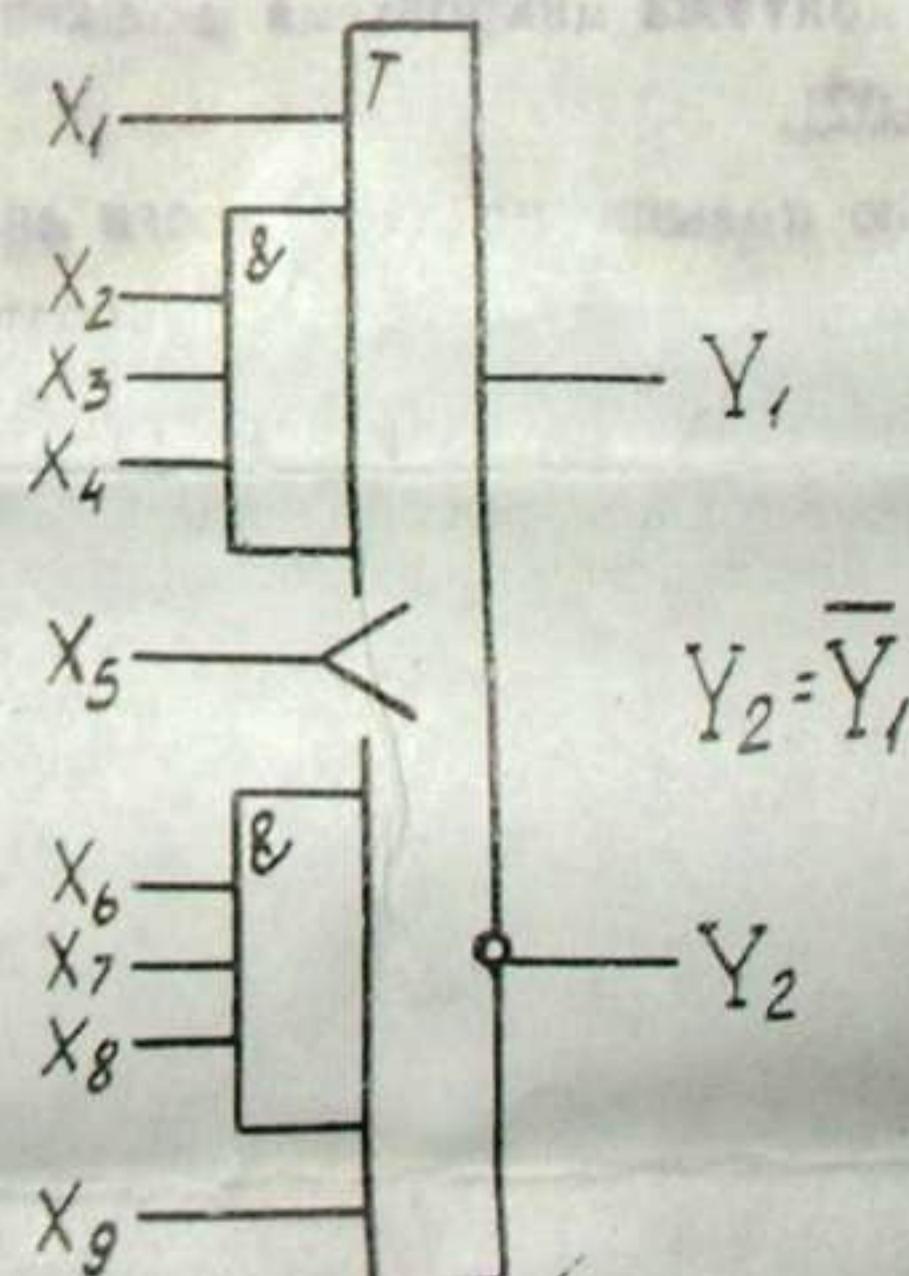
Вес микросхемы не более 1Гр.

Содержание золота в одной микросхеме
7,3189 мг

Локальное золочение 3,1246 мг

Напряжение питания $E = +5V \pm 5\%$

Выход	НАЗНАЧЕНИЕ	Выход	НАЗНАЧЕНИЕ
1		8	Выход Y_1
2	Вход установки „0“ X_1	9	Вход X_6 (K_1)
3	Вход X_2 (J_1)	10	Вход X_7 (K_2)
4	Вход X_3 (J_2)	11	Вход X_8 (K_3)
5	Вход X_4 (J_3)	12	Вход синхронизаци. X_5
6	Выход Y_2	13	Вход установки „1“ X_9
7	Общий	14	Питание $+E$



Электрические параметры при температуре $+20 \pm 5^{\circ}\text{C}$

Наименование	Обозначение	Един. измер.	Нормы
Нагрузочная способность	N		10
Выходное напряжение „лог 0“	$U_{(0)}_{\text{вых}}$	в	не более 0,4
Выходное напряжение „лог 1“	$U_{(1)}_{\text{вых}}$	в	не менее 2,4
Максимальная частота деления	f_{max}	мГц	не более 10

Предельно допустимые условия эксплуатации

Диапазон рабочей температуры от минус 10 до $+70^{\circ}\text{C}$

Предельно допустимое кратковременное напряжение питания составляет 7 в в течение времени 5 миллисекунд
Срок хранения—12 лет.

Время гарантийной наработки.

Гарантируется соответствие микросхемы требованиям частных технических условий при наработке 10000 часов.

Гарантии исчисляются со дня приемки микросхемы представителем ОТК.

Указания и рекомендации по эксплуатации

Крепление микросхемы к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом пайки выводов.

Расстояние от места пайки вывода до корпуса микросхемы должно быть не менее 2,5 мм.
Пайку следует производить с принятием мер, исключающих повреждение микросхемы из-за перегрева и механических усилий.

При пайке рекомендуется применять припой ПОС-61 (ГОСТ 1499-70) и флюс ФКСП [по НО.054.063.

При пайке с помощью паяльника последний должен быть обязательно заземлен и иметь мощность не более 60 вт.

При пайке температура не должна превышать 260°C , а время воздействия этой температуры на микросхему не более 5 сек.

При монтаже руководствоваться указаниями черт. 0.308.008ГЧ.

После монтажа микросхема должна быть защищена в соответствии с нормалью НО.054.021.

С целью повышения надежности аппаратуры рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева корпуса микросхем и защиту от воздействия климатических факторов.

При ремонте аппаратуры замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Дата выпуска 02.25

Штамп ОТК

ОТК 244

200